香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。



### SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司 \*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 00981)

## 海外監管公告

本公告乃中芯國際集成電路製造有限公司(Semiconductor Manufacturing International Corporation,「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於2025年前三季度計提資產減值準備的公告》, 僅供參閱。

> 承董事會命 中芯國際集成電路製造有限公司 公司秘書 / 董事會秘書 郭光莉

中國上海, 2025年11月13日

於本公告日期,本公司董事分別為:

### 執行董事

劉訓峰

### 非執行董事

魯國慶

陳山枝

楊魯閩

黄登山

## 獨立非執行董事

范仁達

劉明

吳漢明

陳信元

\* 僅供識別

A股代码: 688981 A股简称: 中芯国际 公告编号: 2025-031

港股代码: 00981 港股简称: 中芯国际

# 中芯国际集成电路制造有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 一、本次计提减值准备的情况概述

中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的合并财务状况及 2025 年前三季度的经营成果。基于谨慎性原则,公司对合并范围内的各项资产进行了减值迹象的识别和测试,并根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司 2025 年前三季度累计计提信用减值损失和资产减值损失金额为人民币 917,354 千元。具体情况如下表所示:

单位: 人民币千元

项目	2025 年前三季度	备注
信用减值损失	32,123	应收账款及其他应收款坏账 准备计提
资产减值损失	885,231	存货跌价准备计提
合计	917,354	/

## 二、计提减值准备事项的具体说明

## (一) 信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,考虑了不同客户的信用风险特征,对应收账款、其他应收款进行减值测试并计提减值准备。2025年前三季度计提信用减值损失共计人民币32,123千元。

## (二) 资产减值损失

公司评估存货可变现净值,并按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时,公司考虑存货的持有目的,同时结合存货的库龄、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。2025 年前三季度计提存货跌价损失共计人民币 885,231 千元。

## 三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提的信用减值损失及资产减值损失将减少公司 2025 年前三季度合并 利润总额人民币 917,354 千元。本次计提的信用减值损失和资产减值损失数据未 经审计。

## 四、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的合并财务状况及 2025 年前三季度的经营成果,不涉及会计计提方法的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司 董事会 2025年11月14日